

Title (en)

Process to open soldered contacts of a relay and circuit to execute the same.

Title (de)

Verfahren zum Lösen der Kontakte eines klebenden Relais sowie Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens.

Title (fr)

Procédé pour ouvrir les contacts soudés d'un relais ainsi que circuit pour son exécution.

Publication

EP 0294794 A2 19881214 (DE)

Application

EP 88109154 A 19880608

Priority

DE 3719298 A 19870610

Abstract (en)

In a process for releasing the contacts of a sticking relay (14), whose one contact (20) is arranged in a fixed position and whose other contact (22) is arranged on the ferromagnetic relay armature (34), which relay armature is drawn with its contact (22) towards the fixed-position contact (20) by the application of an electrical voltage to the relay coil (46) winding, and which drops again when no current is passing through the relay coil (46) and the relay (14) is intact, as a result of which the two contacts (20, 22) are separated from one another again, sticking together of the relay contacts (20, 22) is detected and, in the event of relay contacts (20, 22) sticking together, an AC voltage or a pulsating DC voltage is applied to the relay coil (46) winding.

Abstract (de)

Bei einem Verfahren zum Lösen der Kontakte eines klebenden Relais (14), dessen einer Kontakt (20) ortsfest und dessen anderer Kontakt (22) am ferromagnetischen Relaisanker (34) angeordnet ist, der mit seinem Kontakt (22) durch Anlegen einer elektrischen Spannung an die Wicklung der Relaisspule (46) zum ortsfesten Kontakt (20) hin angezogen wird und der im stromlosen Zustand der Relaisspule (46) bei intaktem Relais (14) wieder abfällt, wodurch die beiden Kontakte (20, 22) wieder voneinander getrennt werden, wird ein Zusammenkleben der Relaiskontakte (20, 22) festgestellt und wird bei zusammenklebenden Relaiskontakten (20, 22) eine Wechselspannung oder eine pulsierende Gleichspannung an die Wicklung der Relaisspule (46) angelegt.

IPC 1-7

H01H 3/00; **H01H 47/00**

IPC 8 full level

H01H 3/00 (2006.01); **H01H 47/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01H 3/001 (2013.01 - EP US); **H01H 47/002** (2013.01 - EP US); **H01H 2047/003** (2013.01 - EP US)

Cited by

DE10160106B4; FR2959593A1; EP0573771A1; US5455733A; WO2023180582A1

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0294794 A2 19881214; **EP 0294794 A3 19900829**; **EP 0294794 B1 19930811**; DE 3719298 A1 19881222; DE 3719298 C2 19910207; DE 3883086 D1 19930916; ES 2043728 T3 19940101; US 4914315 A 19900403

DOCDB simple family (application)

EP 88109154 A 19880608; DE 3719298 A 19870610; DE 3883086 T 19880608; ES 88109154 T 19880608; US 20485288 A 19880610